



各位

平成 28 年 12 月 21 日

会社名	TDK 株式会社
代表者	代表取締役社長 石黒 成直 (コード番号 6762 東証第 1 部)
問合せ先責任者	広報グループゼネラルマネージャー 丸川 純夫 (TEL 03-6852-7102)

## 米国 InvenSense 社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

TDK 株式会社（代表取締役社長：石黒成直、以下、当社）は、平成 28 年 12 月 21 日開催の取締役会において、慣性センサのグローバルカンパニーである米国 InvenSense, Inc. (Preseident and CEO: Behrooz Abdi、以下、InvenSense 社) の株式を取得し、当社の完全子会社とすること（以下、本件買収）について、InvenSense 社と最終契約を締結することを決議しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

本件買収の実行は、InvenSense 社の株主総会における承認および規制当局の承認の取得を前提としており、平成 30 年 3 月期の第 2 四半期に完了することを予定しております。

### 1. 本件買収の目的

当社は現在、平成 30 年 3 月期までの 3 か年の中期経営計画において、自動車、産機・エネルギー、ICT（情報通信技術）を重点 3 領域と位置づけて注力しており、これら重点領域を通し IoT 領域における事業機会を獲得すべく鋭意事業拡大を進めております。特に、「センサ・アクチュエータ」、「エネルギーユニット」、「次世代電子部品」の 3 製品を戦略成長製品と位置づけ、成長投資を積極的に行い事業拡大を図っております。このうち、センサ・アクチュエータは、IoT には欠かせない重要なデバイスであり、当社はセンサ事業を大きく発展させ、顧客に幅広いセンサソリューションを提供することを目指しております。今回、慣性センサのグローバルカンパニーである InvenSense 社を買収することによって、当社のセンサ事業は、製品・技術の双方においてポートフォリオが拡充され、IoT・車載向けを含めたラインアップの増強ができます。また、革新的な次世代製品とソリューションを創出するセンサ製品ロードマップの促進が可能となります。加えて、複数のセンサ技術とソフトウェアを組み合わせ、より高い付加価値を有する製品を提供するセンサフュージョンにより、更なる事業機会も狙うことができます。

InvenSense 社は、世界に先駆けて 6 軸・9 軸センサ、センサソリューションを手掛けてきた慣性センサの企業であり、慣性・圧力・音声・超音波センサ技術に基づく幅広いポートフォリオを展開しているファブレスメーカーです。同社は、独自の CMOS・MEMS 製造プロセスにより、ハイパフォーマンスを低コストにて実現してしていること、また、ソフトウェアやアルゴリズムを自社で開発することにより付加価値の高いソリューションを提供していることから、スマートフォンやウェアラブル機器、ゲーム機器、カメラの手振れ補正等のコンシューマー機器で多くの取引実績を築き上げて参りました。今後は、インドナビゲーション、VR（仮想現実）や AR（拡張現実）、ADAS（先進運転支援システム）

の需要拡大を筆頭に、ICTに加えてIoTや産業機器、自動車といった領域においても成長が期待されております。

当社のセンサ事業については、長年、HDD（ハードディスクドライブ）の製品開発で蓄積した薄膜磁性技術を応用した磁気センサを中核とし、現在、事業拡大を図っております。今年3月にはスイスのミクロナス社（Micronas Semiconductor Holding AG）を買収し、また、今年8月にはフランスのトロニクス社（Tronics Microsystems SA）の買収を決定しております。今回の買収は、InvenSense社が保有する先進的な慣性センサ技術と、当社が強みを持つ磁気・圧力・温度・音声センサといった幅広いポートフォリオを組み合わせることで、幅広い技術・製品ラインアップを顧客へ提供することが可能となるだけでなく、複数のセンサにより出力されたデータを組み合わせたセンサフュージョン、ソフトウェアを組み合わせたセンサソリューション等の、より高い付加価値のある製品を生み出すことが可能となります。本件買収は、当社の掲げる重点3領域におけるより一層の事業規模拡大と、戦略成長製品の一つであるセンサ事業を将来の当社を支える柱事業の一つとして更に強化するための施策です。

なお、当社は今年1月にQualcomm Incorporatedとの間で、合弁会社RF360 Holdings Singapore PTE, Ltd.の設立、および受動部品、電池、非接触給電、センサ、MEMS等を含めた次世代モバイル通信、IoTおよび自動車関連領域における広範囲な技術協力の拡大について合意しております。この協業体制を通じて、ICT、IoT、自動車領域におけるInvenSense社の顧客基盤の拡大、さらなるシナジー効果によるセンサソリューションの提供も可能となります。

## 2. 本件買収の方法

本件買収は、米国の企業再編法制に基づき、当社が新設した子会社（以下、合併子会社）と、InvenSense社とを合併させる手法で行います<sup>(\*)</sup><sup>(\*\*)</sup>。この手続きを通じて当社は、InvenSense社の既存株主に現金対価を支払うことにより、InvenSense社の株式を100%取得します。

買収金額は約1,334百万米ドル（約1,572億円（1株当たり13.00米ドル（1米ドル118円換算）））となる見込みです。本件買収のための資金については、当社の手元資金で充当する予定です。

(\*1) 米国の企業再編法制上 Reverse Triangular Merger と呼ばれる手続きで、我が国における三角合併に類似した手法です。米国における友好的買収の際に一般的に用いられております。

(\*2) 合併子会社は、当社が TDK U.S.A. Corporation（当社の完全子会社であるデラウェア州法人、以下、TDK USA）を通じて株式を保有する、当社の間接的な完全子会社です。当社は、合併の実行までの間に、合併契約上の当社の権利義務の全てを TDK USA に譲渡する予定です。かかる場合、当社は、TDK USA を通じて InvenSense 社の株式を取得することとなります。

## 3. 株式を取得する当社子会社の概要

(1)	名 称	TDK U.S.A. Corporation
(2)	所 在 地	455 RXR Plaza Uniondale, NY 11556 U.S.A.
(3)	代表者の役職・氏名	President and CEO: Frank Sweeney
(4)	事 業 内 容	米国における地域統括会社
(5)	資 本 金	458,727 千米ドル

(注) 上記2. 記載のとおり、当社は、合併の実行までの間に、合併契約上の当社の権利義務の全てを TDK USA に譲渡する予定です。かかる場合、当社は、TDK USA を通じて InvenSense 社の株式を取得することとなります。

4. 異動する子会社（InvenSense 社）の概要

(1) 名 称	InvenSense, Inc. (NYSE : INVN)		
(2) 所 在 地	1745 Technology Drive San Jose, California 95110		
(3) 代表者の役職・氏名	Preseident and CEO: Behrooz Abdi		
(4) 事 業 内 容	慣性センサ、加速度センサ、角速度センサ、磁気コンパス、音声センサ等の各種センサおよび制御ソフトウェアの開発、製造および販売		
(5) 資 本 金	303,200 千米ドル (2016年4月3日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	2003年6月		
(7) 大株主および持株比率 (2016年7月3日現在)	Artiman, LLC	6.9%	
	The Vanguard Group, Inc.	5.8%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	資本関係はありません	
	人 的 関 係	人的関係はありません	
	取 引 関 係	取引関係はありません	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績および連結財政状態			
決算期 (単位：百万米ドル)	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期
連 結 純 資 産	313.8	359.5	378.7
連 結 総 資 産	494.7	585.7	622.5
1株当たり連結純資産 (米ドル)	3.55	3.87	4.07
連 結 売 上 高	252.5	372.0	418.4
連 結 営 業 利 益	10.0	5.9	2.9
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	6.1	(1.1)	(21.2)
1株当たり連結当期純利益 (米ドル)	0.07	(0.01)	(0.23)

5. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (所有割合：0.0%)
(2) 取 得 株 式 数	102,619,444株 <sup>(*)3</sup> (議決権の数：102,619,444個)
(3) 取 得 価 額	InvenSense社の普通株式 1,334百万米ドル アドバイザー費用等：8百万米ドル
(4) 異動後の所有株式数	102,619,444株 (議決権の数：102,619,444個) (議決権所有割合：100.0%)

(\*)3 本日現在の完全希薄化ベースの株式数を基準としております（本件買収に伴う株式関連報酬の精算による希薄化等を反映）。小数点以下については四捨五入しております。

## 6. 日程

(1) 当社取締役会決議日	平成28年12月21日
(2) InvenSense 社取締役会決議日	平成28年12月21日
(3) 合併契約締結日	平成28年12月21日
(4) InvenSense 社合併承認株主総会決議	平成29年3月期第4四半期中(予定)
(5) 本件買収実行日	平成30年3月期第2四半期(予定)

(注) 本件買収の実行は、米国その他の国の規制当局による承認ならびに典型的なクローリング条件の充足が条件となります。

## 7. 今後の見通し

本件買収が成立した場合、InvenSense 社は当社の連結子会社となります。これに伴う当社の連結業績に与える影響については本買収の進捗状況に応じ、速やかに開示します。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成28年10月31日公表分) および前期連結実績

(単位:百万円)

	売上高	営業利益	税引前当期純利益	当社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成29年3月期)	1,140,000	76,000	75,000	52,000
前期連結実績 (平成28年3月期)	1,152,255	93,414	91,839	64,828

本件買収では、BofA Merrill Lynch が当社の単独のファイナンシャルアドバイザーを務め、ジョーンズ・デイ法律事務所が当社のリーガルカウンセルを務めております。InvenSense 社においては、Qatalyst Partners がファイナンシャルアドバイザーを務め、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman がリーガルカウンセルを務めております。

## 追加情報及びその入手方法

TDK 及び InvenSense は、企図されている取引につき、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に対し、関連する資料を提出する予定です。また、InvenSense は、SEC に対し、Schedule 14A による委任勧誘状(Proxy Statement)を提出する予定です。InvenSense は、SEC に対する最終的な委任勧誘状の提出後、企図されている取引に関する InvenSense の臨時株主総会において議決権を有する各株主に対し、最終的な委任勧誘状及び委任状書面(Proxy Card)を郵送します。これらの文書(その変更及び補遺を含みます。)並びに TDK 又は InvenSense が SEC に提出するその他の関連文書には、TDK、InvenSense 及び企図されている取引に関する重要な情報が含まれる予定ですので、投資家及び InvenSense に関する有価証券の保有者の皆様におかれましては、これらの文書が利用可能な状態になりましたら、これらの文書の全体を注意してお読みになるようお願いいたします。委任勧誘状及び InvenSense が SEC に提出するその他の文書は、InvenSense のウェブサイト(www.invensense.com)又は SEC のウェブサイト(www.sec.gov)において無料で閲覧可能です。また、これらの文書は、InvenSense に郵送(住所: InvenSense, Inc., 1745 Technology Drive Suite 200, San Jose, California 95110 宛先: Investor Relations)又は電話(電話番号: +1 (408) 501-2200)で請求することによって、無料で取得することができます。TDK が SEC に対して提出した文書については、SEC のウェブサイト(www.sec.gov)において無料で閲覧可能です。また、これらの文書は、TDK に郵送(住所: 〒108-0023 東京

都港区芝浦三丁目 9 番 1 号芝浦ルネサイトタワー 宛先:広報グループ IR チーム)で請求することによって、無料で取得することができます。

本資料は、委任状の勧誘、又はいかなる有価証券の買付けの申込み若しくは売付けの申込みの勧誘も意図するものではありません。TDK 及び InvenSense 並びにこれらの取締役、執行役員及び従業員のうち一定の者は、企図されている取引に関する InvenSense の株主に対する委任状勧誘の主体とみなされる可能性があります。SEC の規則に基づき企図されている取引に関する InvenSense の株主に対する委任状勧誘の主体とみなされる者に関する情報、及びこれらの者が企図されている取引に関して有している直接的又は間接的な利害関係(有価証券の保有等)は、InvenSense が SEC に提出予定である最終的な委任勧誘状に記載される予定です。InvenSense の取締役及び執行役員並びにこれらの者が所有する InvenSense の有価証券に関する情報は、2016 年 7 月 29 日付で SEC に提出された InvenSense の 2016 年度定時株主総会のための最終的な委任勧誘状、及び 2016 年 5 月 25 日付で SEC に提出された InvenSense の 2016 年 4 月 3 日に終了した事業年度に関する Form 10-K による年次報告書(Annual Report)に記載されています。これらの書類は、SEC のウェブサイト(www.sec.gov)において無料で閲覧可能です。

### 将来の予測に関する記述

本資料には、将来の予測に関する記述(forward-looking statement)が含まれています。これらの記述は、例えば、TDK 及び InvenSense 間の取引の実行に関する日程の予測、当該取引により予測される恩恵及びシナジー、TDK 及び InvenSense の計画、目標及び予測、並びに当該取引に起因する TDK の製品提供、製品開発、市場における地位及び技術的発展に関する予測等を含む幅広い事項について言及しています。過去の事実に関するものではないあらゆる記述(意見、計画及び予測に関する記述を含みます。)は、将来の予測に関する記述に該当します。かかる将来の予測に関する記述は、現時点の予測に基づくものであり、多くの要因又は不確定要素の影響を受けます。将来の予測に関する記述は、過去の事実ではなく、リスク及び不確定要素により、実際の結果がその記述の内容と著しく異なることとなる可能性があります。将来の予測に関する記述には、InvenSense の事業及びその業界全般に関する将来の事象についての TDK 経営陣の現時点における予測、目算、意見、仮定及び計画に基づく記述が含まれます。将来の予測に関する記述には、「予測する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「希望する」、「見積もる」、「可能である」、「する予定である」、「すべきである」、「かもしれない」、「可能性」、「継続する」、「目的」、「目標」との語及びこれらの語の変形(若しくはこれらの語の否定形)又は未来若しくは将来を予測する性質を有するその他の類似の表現が伴います。また、将来の事象又は状況(その基礎となる前提条件を含みます。)に関する計画その他の描写に言及するあらゆる記述は、将来の予測に関する記述に該当します。実際の結果は、将来の予測に関する記述において予測又は予想された結果と著しく異なることとなる可能性があります。実際の結果が将来の予測に関する記述の内容と著しく異なりうる要因及び不確定要素には、①各当事者が企図されている取引を実行するための前提条件(株主による承認及び規制上の承認の取得を含みますが、これらに限られません。また、規制上の承認の取得については、規制当局が、企図されている取引に関し、一部事業の売却等を要求する可能性を含みます。)を充足することができるか否か、②合併契約の解除原因となる事象の発生、③企図されている取引に関する予期しない困難又は支出、④企図されている取引の公表後に TDK、InvenSense その他の者に対して提起されうる法的手続、⑤企図されている取引の公表又は係属により惹起される現在の計画及び事業運営に対する阻害、⑥企図されている取引により予測される恩恵、シナジー及び成長見通しが適時に達成されない可能性に関するリスク、⑦取引実行後に InvenSense の事業を TDK の事業に成功裏に統合できない可能性に関するリスク、⑧企図されている取引の公表又は係属に伴う従業員の維持に関する潜在的な困難、並びに⑨企図されている取引の公表に対する顧客、販売代理店、仕入先及び競合他社の反応等が含まれますが、これらに限られません。実際の結果が将来の予測に関する記述の内容と著しく異なりうる要因に関する追加の情報については、(それが閲覧可能となった時点で)委任勧誘状及び InvenSense の SEC に対する提出書類(InvenSense の直近の Form 10-K による年次報告書に記載されているリスク要因を含みます。)をご参照下さい。将来の予測に関する記述は、現時点における経営陣の予測を反映したものであり、その本質的に不確実なものです。法令により義務付けられる場合を除き、TDK 及び InvenSense のいずれも本資料に記載される情報を更新する義務を負いません。将来の予測に関する記述は、現時点において述べられるもの

であり、その読者はかかる記述に過度に依拠すべきではありません。